

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成 18 年 1 月 19 日 (2006.1.19)

【公開番号】特開 2000-275059 (P2000-275059A)
 【公開日】平成 12 年 10 月 6 日 (2000.10.6)
 【出願番号】特願 平 11-83641
 【国際特許分類】

G 0 1 D 5/245 (2006.01)

G 0 1 R 33/09 (2006.01)

【F I】

G 0 1 D 5/245 R

G 0 1 R 33/06 R

【手続補正書】
 【提出日】平成 17 年 11 月 25 日 (2005.11.25)

【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 6
 【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 6】

また、図 8 a) もしくは図 8 b) に示す方式がある。図 8 a) は、四弗化エチレン系樹脂やポリアミド系樹脂シート 7 を磁気媒体 1 の外周に貼り付ける構成である。図 8 b) は磁気センサ素子 3 にシート 7 を貼付け、前記シートを介して磁気媒体 1 と磁気センサ 2 を接触、摺動する方式である。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 1 5
 【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 5】

前記 F P C の樹脂部の厚さを磁気センサと磁気記録媒体との間隔に等しくし、磁気媒体と F P C 樹脂部を介して磁気センサを押しつけるだけでギャップ g が容易に得られ、工数のかかるギャップ調整が容易になるばかりではなく、磁気媒体や磁気センサ表面の傷の発生も防ぐことができる。

【手続補正 3】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 2 8
 【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 8】

F P C は、薄型と呼ばれているものでポリアミド系樹脂シート 25 μm 、接合接着層 35 μm 、銅回路層 35 μm 、接合接着層 35 μm 、ポリアミド系樹脂シート 25 μm の 5 層で合計 155 μm 厚のものを使用した。磁気センサ素子 3 を覆うように F P C の樹脂部 15 が配置されるが、銅回路層 35 μm 、両側の接合接着層、片側のポリアミド樹脂シートが無い場合 F P C の樹脂部 15 は 25 μm の厚みである。F P C の樹脂部 15 は磁気センサ素子 3 とは樹脂等で接着されることなく、銅回路層厚 35 μm と接合部 8 の半田厚に約 10 μm の合計約 45 μm の空隙を磁気センサ素子 3 との間に持った状態で保持されている。

以 上